

2026/07/23

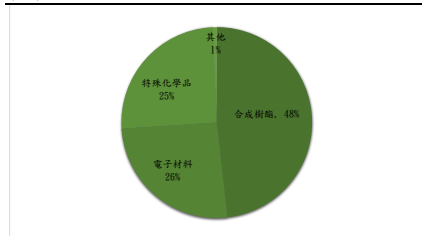
臺灣 ESG 永續指數成分股

潛在漲幅	37.3%
前日收盤價	62.60 元
目標價	86.00 元
前次目標價	--
前次評等	--

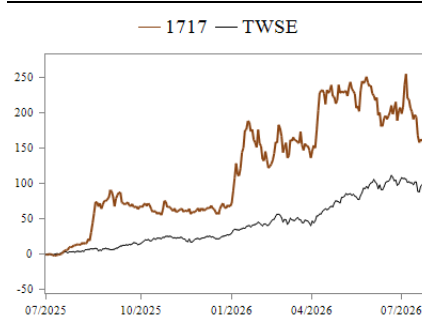
公司基本資訊

目前股本(百萬元)	11,842
市值(億元)	741
目前每股淨值(元)	24.57
外資持股比(%)	11.08
董監持股比(%)	14.24

營業比重



個股與大盤走勢(%)



江釗亨

Joseph.chiang@ctbcis.com

化工

長興 (1717 TT)

重新覆蓋

買進(Buy)

成功打入半導體封裝材料供應鏈

- 1Q26 毛利率仍持續提升且優於市場預期
- 從傳統樹脂供應商轉型為高階半導體材料關鍵供應商
- 產品組合優化及反應原物料成本上漲，毛利率可望提升

長興毛利率表現可望優於市場預期：長興 1Q26 財報合併營收 102.43 億元，較去年同期成長 1.81%，單季毛利率 22.16%，較上季度增加 0.87 個百分點，主要因應低價庫存效應及成本上漲，產品價格反映成本調漲以反映原料成本的變動；營業利益 5.35 億元 YoY+19.55%，營業利益率(OPM)提升至 5.22%，較去年同期增加 0.77 個百分點，1Q26 稅後歸屬母公司獲利 4.28 億元 YoY+22.66%，單季 EPS 約 0.37 元，優於市場預期的 0.35 元。自結 01~06/2026 合併營收 221.68 億元 YoY+8.32%；自結累計 01~05/2026 稅前獲利 15.07 億元 YoY+67.66%，累計 01~05/2026 稅前 EPS 約 1.29 元。

成功打入半導體材料 2H26 將量產貢獻營收 4~5%：長興材料成功研發高毛利的液態封裝材料 MUF(模塑底部填充)與 LMC(液態封裝材料)，已打入台積電 CoWoS 先進封裝供應鏈，預計 2026 年成為 Apple 新款 M8 處理器獨家材料供應商，1H26 單月營收約 2,000~3,000 萬元，估計 2H26 隨產量提升營收貢獻可望提升至 1~1.5 億元/月，預估佔營收貢獻約 4~5%，半導體產品毛利率高達 40~50%，隨著量產營收貢獻度提升，可望帶動長興整體毛利率提升。

長興布局有成，全球熱塑複材市場長期看漲：全球複合材料市場正從熱固性轉向熱塑性，特別是在航空航太、汽車輕量化與電子產品的驅動下，預估全球熱塑複合材料市場至 2030 年將提升至 865 億美元，2025~2030 年複合成長率(CAGR)約 8.1%。長興熱塑複材 ETERPLAST 產品適合大規模量產、降低生產成本且生產週期短，提供從材料開發到成型工藝的一站式解決方案，且持續開發低碳排、可降解或生物基的化學材料，強化在半導體與能源材料市場的滲透率。

展望 2026~2027 年半導體材料貢獻度提升，毛利及獲利可望走升：展望 2026 年受惠半導體先進封裝材料貢獻提升與精密設備出貨增加，營運可望持續成長；投顧預估長興 2026/2027 年營收 465.06/508.94 億元，獲利方面展望高毛利半導體材料逐漸量產，佔營收比重逐漸提升，產品組合持續優化，且產品售價反映原物料價格提升，毛利率可望逐漸改善提升貢獻獲利成長，預估 2026/2027 年稅後 EPS 各約 2.28/3.09 元，目標價 86 元(2027 PER 28 倍)。

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	49,014	42,452	44,191	40,685	46,506	50,894
營業毛利淨額	10,163	8,147	8,824	8,368	10,828	12,352
營業利益	3,277	1,915	2,170	1,692	3,425	4,621
稅後純益	2,618	1,504	1,835	1,656	2,705	3,656
公告基本 EPS(元)	2.15	1.28	1.56	1.41	--	--
調整後 EPS(元)	2.22	1.28	1.56	1.41	2.28	3.09
營業收入 YoY(%)	-2.89%	-13.39%	4.10%	-7.93%	14.31%	9.44%
稅後純益 YoY(%)	-26.25%	-42.55%	22.00%	-9.75%	63.39%	35.15%
本益比	12.86	20.88	16.80	28.64	27.40	20.28
本淨比	1.32	1.27	1.09	1.71	2.38	2.13
股息(元)	1.20	0.80	1.20	1.00	1.50	2.00
殖利率(%)	3.70%	2.56%	4.51%	1.27%	2.39%	3.19%
ROE(%)	10.68%	6.08%	6.92%	5.91%	9.21%	11.11%

2026/07/23

● 長興材料專注於化學電子材料之製造、加工及銷售

長興材料工業股份有限公司，成立於 1964 年，是台灣化學工業的領導廠商，總部位於高雄。長興以合成樹脂起家，經過 60 年的發展，已轉型為全球知名的高科技化學材料供應商，每年投入約 5% 的營收於研發，展現對技術創新的重視，由於長期投注研發，使得長興擁有走在時代尖端的技術，並在業界維持領先優勢，長興的核心技術在於高分子合成、配方技術、應用技術、材料分析技術及製程技術，長興成功運用核心技術優勢，使得長興由傳統樹脂產業，轉型為高科技產業製程原料專業供應商。長興全球布局全球生產基地共有 24 個，主要分佈於台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、越南及義大利。長興的業務由三大事業單位組成，應用範疇極廣，主要三大事業單位佔 2025 年收比重分別為合成樹脂 48.22%、電子材料 25.75%、特殊化學品 25.43% 及其他 0.60%。

圖表一、長興 2025 年主要事業單位產品項目營收比重分佈(%)

主要事業單位	2025 年 營收占比	主要產品項目
合成樹脂	48.22%	涵蓋塗料樹脂、不飽和聚酯樹脂等，應用於建築、交通車輛及工業防蝕。
電子材料	25.75%	包括印刷電路板(PCB)用材料、乾膜光阻、防焊漆、液態聚醯亞胺材料、UV 硬化型文字油墨等。
特殊化學品	25.43%	主攻光固化單體與寡聚物、特殊塗料、壓敏膠、黏結膠、硅材料、UV 成型材料等。
其他	0.60%	體外檢測酵素、鋰電池水性樹脂、5G 高頻材料、熱塑複材等、半導體封裝、碳矽負極。

資料來源：長興材料，中信投顧整理

圖表二、長興全球生產基地布局

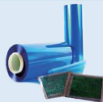
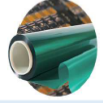
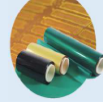


資料來源：長興材料，中信投顧整理

2026/07/23

2025 年長興電子材料產品佔營收比重 25.75%，主要包括光阻材料、銅箔基板、真空壓模機等產品，長興電子材料(乾膜光阻)全球市占率約 30.78%，乾膜光阻是印刷電路板生產過程中影像轉移製程的關鍵材料，因 AI 相關產品應用帶動高速運算與高頻高速需求，產品結構設計朝向 IC 晶片異質整合 IC 載板層數/尺寸增加、HDI 高密度細線路與 HLC 高層次板高頻高速和消費性產品日益輕、薄及高性能的 FPC 軟板需求；根據 Prismark 研調機構預估至 2029 年電路板產業產值年複合成長率達 5.2%，主要受惠 AI 技術全域進化與終端應用復甦的推動下，呈現持續的成長趨勢，對於未來的表現還是保持著樂觀看法。台灣在全球半導體產業鏈居戰略核心地位，長興將持續推動半導體封裝材料、高階製程設備及 AI 應用相關材料之開發，躋身半導體供應鏈關鍵地位。

圖表三、長興電子材料事業主要產品項目與應用

主要產品	說明	產品應用
Dry Film Photoresist 負型水溶性乾膜光阻	 主要用於印刷電路板(包括硬板、軟板、軟硬複合板、HDI)、導線架、IC基板、IC封裝等精密蝕刻、電鍍等工業之影像轉移製程。	資訊、通訊、汽車、半導體、消費性等電子產品
Dry Film Solder Mask 乾膜防焊光阻(DFSM)	 主要用於軟/硬式印刷電路板、IC載板和其他硬板、高精度金屬基板/陶瓷基板/玻璃基板等精密外層之線路保護(Solder Mask)，屬永久性材料。	資訊、通訊、汽車、半導體、消費性等電子產品
Photo-Imageable-Coverlay (PIC) 感光型覆蓋膜	 低溫150°C烘烤型的高精密乾膜感光弱鹼顯像型光阻，應用於高精度軟性印刷電路板(FPC)/金屬基板外層線路保護。	資訊、通訊、汽車、半導體、消費性等電子產品
Paper Phenolic Copper Clad Laminate 紙基酚醛覆銅箔基板(FR-1)	 酚醛紙基覆銅箔基板係以酚醛樹脂為粘合劑及漂白牛皮紙為增強材料為絕緣層的覆銅電路基板，適用於沖孔與鑽孔加工。	民生家電、資訊周邊、通訊、電源供應器等相關電子產品
Composite Epoxy Copper Clad Laminate 環氧複合銅箔基板(CEM-1)	 是由玻璃布面料及漂白牛皮紙芯料兩種基材組成，產品以單面銅箔基板為主，適用於沖孔與鑽孔加工。	民生家電、資訊周邊、通訊、電源供應器等相關電子產品
Liquid UV Curable Marking Ink UV硬化型文字油墨	 用於雙面及多層印刷電路板文字及圖形標示之網板印刷製程，適用於雙面及多層印刷電路板的文字及圖形標示印刷，油墨硬化後具優異之附著力、耐熱性。	資訊、通訊、汽車、半導體、消費性等電子產品
Liquid Polyimide Material 液態聚醯亞胺材料	 觸控Sensor基材與軟性電子基材，探針卡(Probe card)的介電層材料	平面顯示器與觸控面板、晶圓測試探針卡
Toll Coating Service 精密塗佈代工	 持續累積大量的塗佈技術與經驗，可與業界共同發展高值化的塗佈產品，亦可提供精密塗佈代工服務。	平面顯示器材料、觸控材料、太陽能背板、IC載板增層絕緣膜材
Vacuum Laminator 真空壓膜機	 將各種構裝用薄膜材料以真空壓膜方式，對各種細線路與導通孔之載板表面進行高填覆性壓合，並以高精度熱壓方式使各式載板在壓合後維持均一之厚度與表面平整性。	IC載板、軟性電路板FPC、NCF、LED、半導體等相關製程

資料來源：長興材料，中信投顧整理

● 長興材料 MUF 產品用於先進晶圓級封裝，成長潛力可期

長興材料的模壓底填膠(Molded Underfill; MUF)是先進封裝領域的關鍵材料，主要應用於高密度覆晶封裝(Flip Chip)及 CoWoS 等先進封裝製程。3D IC 將不同功能之晶片整合在一起進行晶圓級或面板級封裝，不僅體積厚度大幅縮小，也達到低功耗要求，是未來高階封裝主流。晶圓級封裝隨晶圓廠或封裝廠製程不同，概分為扇入型(Fan-in)、扇出型(InFO)、及覆晶封裝底膠材料與結構製程合而為一的 MUF(Mold Under Fill)。長興材料成功研發高毛利的液態封裝材料 MUF(模塑底部填充)與 LMC(液態封裝材料)，已打入台積電 CoWoS 先進封裝供應鏈，預計 2026 年成為 Apple 新款 M8 處理器獨家材料供應商，1H26 單月營收約 2,000~3,000 萬元，估計 2H26 隨產量提升營收貢獻可望提升至 1~1.5 億元/月，預估佔營收貢獻約 4~5%。

圖表四、長興晶圓級液態封裝材料特性與用途

產品	特性	用途
晶圓級液態封裝材料(EI-6042)	1.低翹曲 2.對 Si 晶片和 Cu 界面展現優異的密著力 3.極佳的窄縫隙填充流動性	1. Fan-out (Die first 型式，包含研磨和 PI 塗佈 RDL 製程) 2. Fan-out (RDL first 型式，只需 MUF 製程) 3. SiP 系統級封裝 4. MUF 封裝底部填充膠

資料來源：長興材料，中信投顧整理

● 長興入選矽光子國家隊，唯一入選化工廠商

台灣「矽光子國家隊」在 2025 年底成形，由經濟部補助並攜手 SEMI 矽光子產業聯盟，主要存在整合台積電、聯發科、日月光等台廠，解決技術缺口、強化供應鏈自主，期望存在 2028 年奠定 AI 高速傳輸領域的全球關鍵地位，預計 2025~2028 年投入 29 億元預算，重點技術研發與人才培育，建置研發環境以建立自主供應鏈；長興成功研發的封裝膠材成功切入台積電先進封裝製程，已成功打入台積電 CoWoS 供應鏈，且產品預計 2026 年下半年量產。長興因在 AI 及先進封裝膠材的技術突破，成為行政院「矽光子國家隊」首波名單中唯一的化工業者。入選矽光子國家隊，也凸顯出長興在先進技術領域的重要性與領導地位。

● 全球熱塑複材市場長期年複合成長率看漲

長興發展的高性能熱塑複材相對於傳統熱固性材料或金屬，纖維長度影響操作性及材料性能，因應不同的產品結構與性能要求，搭配對應的複材產品，達到產品性能最佳化目的；短纖射出粒(SFT)精細複雜產品、功能化配方、具備基礎機械性能；長纖射出粒(LFT)高強韌輕量化結構、適用於次級結構件、可取代部分金屬產品應用；連續纖維(UD)高比強度主結構，最佳的機械性能材料；熱塑複材創新應用領域包括無人機、電動垂直起降(eVTOL)、人形機器人及自行車等領域。全球複合材料市場正從熱固性轉向熱塑性，特別是在航空航太、汽車輕量化與電子產品的驅動下，預估全球熱塑複合材料市場至 2030 年將提升至 865 億美元，2025~2030 年複合成長率(CAGR)約 8.1%。

2026/07/23

長興熱塑複材 ETERPLAST 產品是熱塑樹脂以短纖、長纖維或連續纖維增強材，搭配設計之材料，適合大規模量產、降低生產成本且生產週期短；長興的競爭實力，結合長興在樹脂合成與纖維浸漬的技術根基，提供從材料開發到成型工藝的一站式解決方案，且持續開發低碳排、可降解或生物基的化學材料，強化在半導體與能源材料市場的滲透率。

圖表五、長興熱塑複材 ETERPLAST 產品實績及產研合作案例

應用標的	產業現況	ETERPLAST®	
無人機槳葉	- 熱固材料製作工時長 - 熱塑材料(強度與重量不如熱固材料)	• PA66/PPA SLFT	- 高剛性SLFT - 快速生產 - 材料性質(強度、剛性、韌性)可客製化，依長短纖維混合比例調整
自行車部件	- 鋁合金，金屬CNC費時費工(高精度條件下) - 熱固碳纖維複材	- 熱塑環氧 LFT - PA6 LFT - PA12 UD - PA66 SLFT - PAEK SFT	- 低收縮性材料，產品精度高；高強度 - 快速生產
航太部件	連續纖維熱固複材製作費時費工	- PPA LFT/UD - PPS SLFT - PAEK SLFT/UD	- 多材料複合加工Hybrid molding - 應用於低軌衛星熱塑蜂巢板部件

資料來源：長興材料，中信投顧整理

圖表六、季度財報與預估差異

損益表 (單位：百萬元)	1Q26					2Q26(F)				
	實際數	中信預估	差異	市場共識	差異	調整前	調整後	差異	市場共識	差異
營業收入	10,243	-	-	10,628	-3.6%	-	11,926	-	12,619	-5.5%
營業毛利	2,270	-	-	2,248	1.0%	-	2,770	-	2,997	-7.6%
營業利益	535	-	-	559	-4.2%	-	966	-	1,053	-8.3%
稅前純益	622	-	-	646	-3.6%	-	1,054	-	1,118	-5.7%
稅後淨利	428	-	-	415	3.2%	-	770	-	759	1.5%
EPS(元)	0.37	-	-	0.35	5.7%	-	0.66	-	0.65	1.9%
財務比率(€/百分點)										
毛利率	22.2%	-	-	21.2%	1.0 ppts	-	23.2%	-	23.8%	-0.5 ppts
營益率	5.2%	-	-	5.3%	0.0 ppts	-	8.1%	-	8.3%	-0.2 ppts
稅後淨利率	4.2%	-	-	3.9%	0.3 ppts	-	6.5%	-	6.0%	0.4 ppts

資料來源：Bloomberg，中信投顧預估

圖表七、年度財報與預估差異

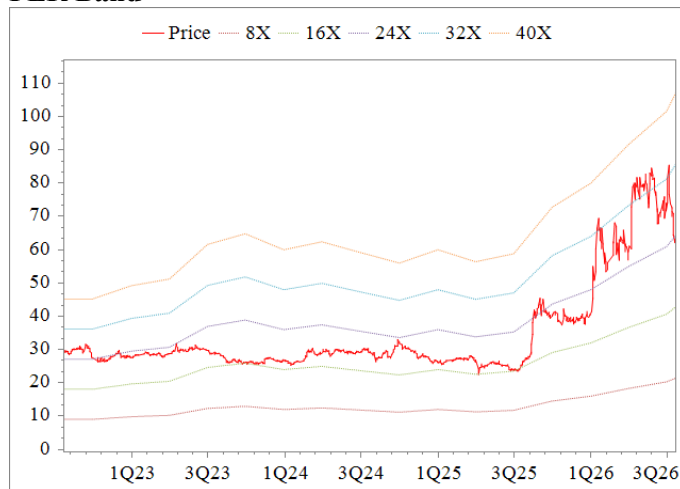
損益表 (單位：百萬元)	2026(F)					2027(F)				
	調整前	調整後	差異	市場共識	差異	調整前	調整後	差異	市場共識	差異
營業收入	-	46,506	-	49,521	-6.1%	-	50,894	-	51,466	-1.1%
營業毛利	-	10,828	-	11,365	-4.7%	-	12,352	-	12,486	-1.1%
營業利益	-	3,425	-	3,615	-5.3%	-	4,621	-	4,249	8.8%
稅前純益	-	3,776	-	3,987	-5.3%	-	4,973	-	4,919	1.1%
稅後淨利	-	2,705	-	2,576	5.0%	-	3,656	-	3,250	12.5%
EPS(元)	-	2.28	-	2.18	4.6%	-	3.09	-	2.73	13.2%
財務比率(€/百分點)										
毛利率	-	23.3%	-	23.0%	0.3 ppts	-	24.3%	-	24.3%	0.0 ppts
營益率	-	7.4%	-	7.3%	0.1 ppts	-	9.1%	-	8.3%	0.8 ppts
稅後淨利率	-	5.8%	-	5.2%	0.6 ppts	-	7.2%	-	6.3%	0.9 ppts

資料來源：Bloomberg，中信投顧預估

2026/07/23

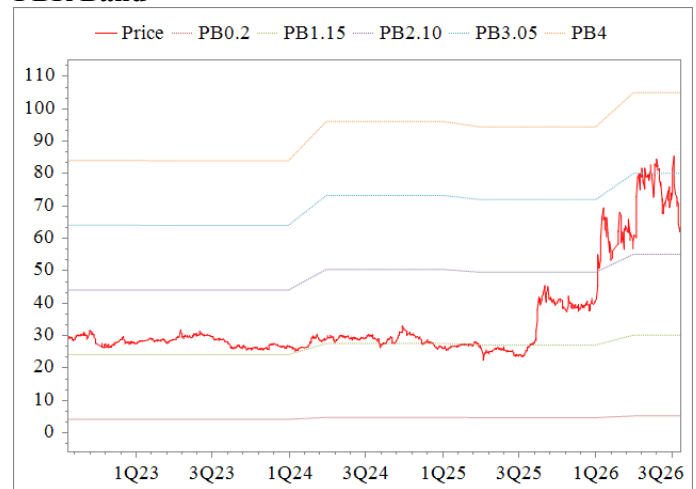
(百萬元)	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
營業收入	10,243	11,926	12,118	12,219	10,749	12,540	13,562	14,044
營業成本	7,973	9,155	9,248	9,301	8,190	9,509	10,244	10,599
營業毛利	2,270	2,770	2,870	2,918	2,559	3,031	3,317	3,445
營業費用	1,735	1,804	1,889	1,975	1,658	1,848	2,043	2,182
營業利益	535	966	981	943	902	1,183	1,274	1,263
營業外收支淨額	87	88	88	88	88	88	88	88
稅前純益	622	1,054	1,069	1,031	990	1,271	1,362	1,351
所得稅	192	276	274	273	266	333	349	357
稅後純益	428	770	789	718	721	935	1,010	990
調整後 EPS(元)	0.36	0.65	0.67	0.61	0.61	0.79	0.85	0.84
毛利率(%)	22.16%	23.23%	23.68%	23.88%	23.81%	24.17%	24.46%	24.53%
營業利益率(%)	5.22%	8.10%	8.09%	7.72%	8.39%	9.43%	9.39%	8.99%
稅後純益率(%)	4.18%	6.46%	6.51%	5.88%	6.71%	7.45%	7.45%	7.05%
營業收入								
QoQ(%)	1.19%	16.43%	1.61%	0.84%	-12.03%	16.66%	8.15%	3.56%
YoY(%)	1.81%	14.62%	20.02%	20.71%	4.94%	5.15%	11.91%	14.94%
營業利益								
QoQ(%)	34.30%	80.56%	1.52%	-3.79%	-4.42%	31.15%	7.72%	-0.86%
YoY(%)	19.55%	82.01%	211.19%	136.83%	68.56%	22.43%	29.91%	33.87%
稅後純益								
QoQ(%)	13.01%	79.83%	2.39%	-8.94%	0.44%	29.58%	8.04%	-1.92%
YoY(%)	22.66%	118.22%	37.25%	89.48%	68.41%	21.35%	28.05%	37.92%

PER Band



資料來源：中信、CMoney

PBR Band



資料來源：CMoney

2026/07/23

資產負債表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	1Q26
資產總計	59,455	58,538	62,419	60,155	62,817
流動資產	35,182	33,030	34,219	30,561	32,876
現金及約當現金	5,451	6,357	7,075	6,044	7,384
應收帳款與票據	17,132	15,213	15,447	14,060	14,896
存貨	9,716	8,479	8,533	8,184	8,348
採權益法之投資	2,323	2,468	2,742	2,750	2,766
不動產、廠房設備	17,473	18,323	20,836	21,682	21,909
負債總計	34,384	33,322	33,429	31,929	32,796
流動負債	17,114	18,193	18,384	17,004	19,435
應付帳款及票據	5,180	5,623	6,285	6,209	6,630
非流動負債	17,270	15,129	15,045	14,925	13,360
權益總計	25,071	25,216	28,991	28,226	30,021
普通股股本	11,783	11,783	11,783	11,722	11,722
保留盈餘	13,586	13,646	14,918	15,367	14,699
母公司業主權益	24,760	24,735	28,314	27,676	28,807
負債及權益總計	59,455	58,538	62,419	60,155	62,817

損益表

(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	42,452	44,191	40,685	46,506	50,894
營業成本	34,304	35,367	32,316	35,678	38,542
營業毛利淨額	8,147	8,824	8,368	10,828	12,352
營業費用	6,232	6,655	6,677	7,403	7,731
營業利益	1,915	2,170	1,692	3,425	4,621
EBITDA	4,619	5,333	5,020	6,619	7,856
業外收入及支出	268	574	697	351	352
稅前純益	2,182	2,744	2,389	3,776	4,973
所得稅	690	870	676	1,015	1,305
稅後純益	1,504	1,835	1,656	2,705	3,656
公告基本 EPS(元)	1.28	1.56	1.41	--	--
調整後 EPS(元)	1.28	1.56	1.41	2.28	3.09

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

現金流量表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	1Q26
營業活動現金	6,581	6,514	4,612	4,265	727
稅前純益	3,515	2,182	2,744	2,389	622
折舊及攤銷	2,089	2,103	2,239	2,276	634
營運資金變動	1,447	3,600	373	1,660	-579
其他營運現金	-469	-1,371	-744	-2,061	50
投資活動現金	-3,643	-3,351	-3,062	-2,811	-228
資本支出淨額	-2,777	-3,135	-3,576	-3,043	-605
長期投資變動	130	-13	-423	740	163
其他投資現金	-996	-204	937	-508	214
籌資活動現金	-1,887	-2,068	-1,044	-2,361	720
長借/公司債變動	26	-1,350	-859	2,013	-1,186
現金增資	0	0	0	0	0
發放現金股利	-1,860	-1,414	-943	-1,414	0
其他籌資現金	-53	696	757	-2,960	1,906
淨現金流量	1,161	932	720	-1,059	1,340
期初現金	4,289	5,451	6,382	7,103	6,044
期末現金	5,451	6,382	7,103	6,044	7,384

資料來源：中信、CMoney

比率分析

(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
成長力分析(%)					
營業收入淨額	-13.39%	4.10%	-7.93%	14.31%	9.44%
營業毛利淨額	-19.83%	8.31%	-5.17%	29.39%	14.08%
營業利益	-41.57%	13.32%	-22.03%	102.46%	34.93%
稅後純益	-43.04%	25.60%	-8.59%	63.39%	35.15%
獲利能力分析(%)					
毛利率	19.19%	19.97%	20.57%	23.28%	24.27%
EBITDA(%)	10.88%	12.07%	12.34%	14.23%	15.44%
營益率	4.51%	4.91%	4.16%	7.36%	9.08%
稅後純益率	3.51%	4.24%	4.21%	5.82%	7.18%
ROE(%)	6.08%	6.92%	5.91%	9.21%	11.11%

ESG 資訊-環境保護(Environmental)

溫室氣體(範疇一/二)排放量

2025

總排放量

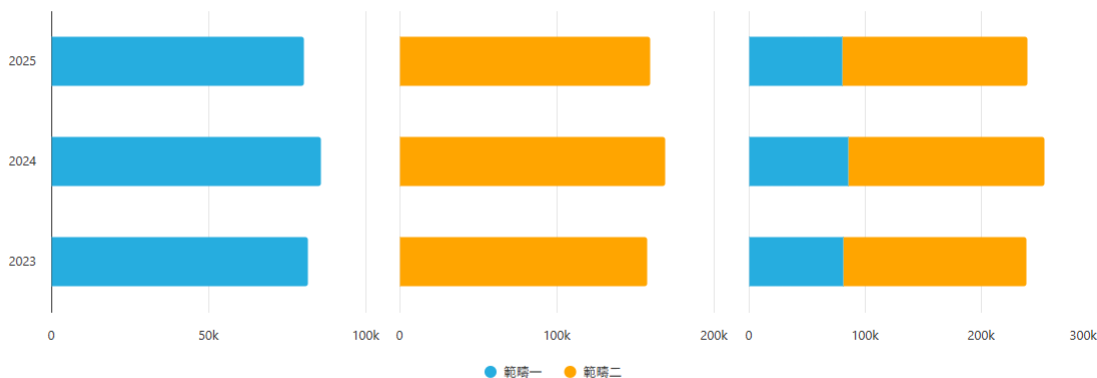
239.97K (YOY) -6% ▼

範疇一

80.39K (YOY) -6% ▼

範疇二

159.57K (YOY) -5% ▼



再生能源使用率

2025

使用率

4% (YOY) -30% ▼

全市場平均使用率

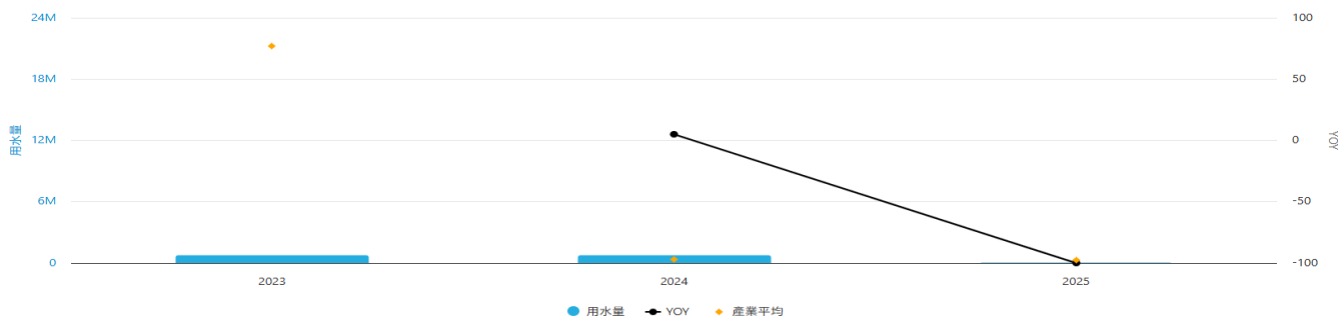
4% (VS. 公司) 35% ▲

產業平均使用率

1% (VS. 公司) 8% ▲



用水量



2025

用水量

1.94K (YOY) -100% ▼

全市場平均用水

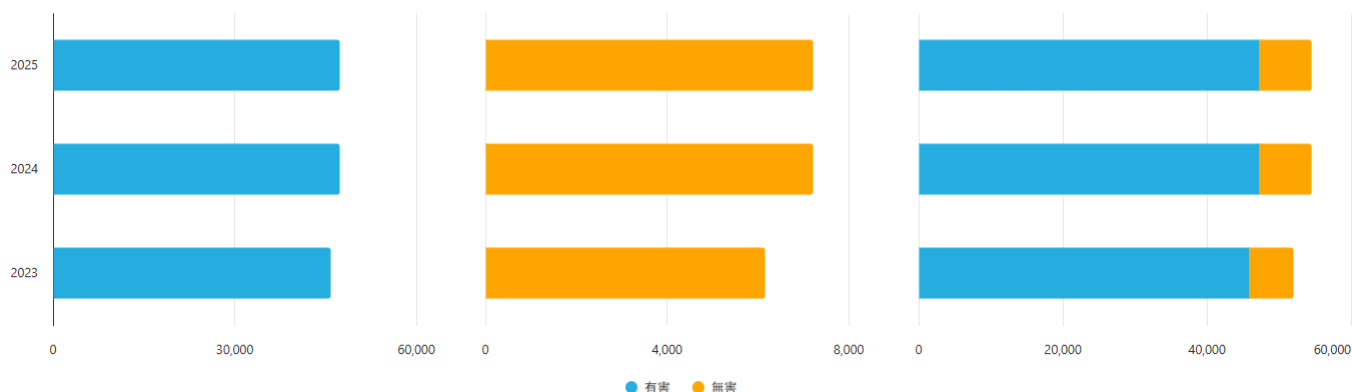
1,864.88K (YOY) 23% ▲

產業平均用水

286.56K (YOY) -19% ▼

2026/07/23

廢棄物量



2025



密集度

2025

溫室氣體排放密集度

0.39

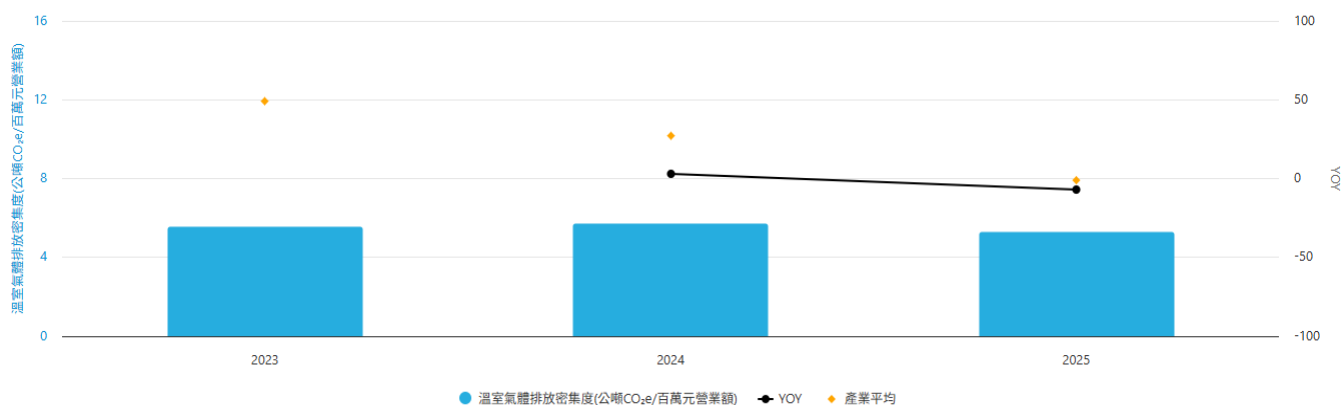
用水密集度

0.027

廢棄物密集度

0.088

溫室氣體排放密集度(公噸CO₂e/百萬元營業額)



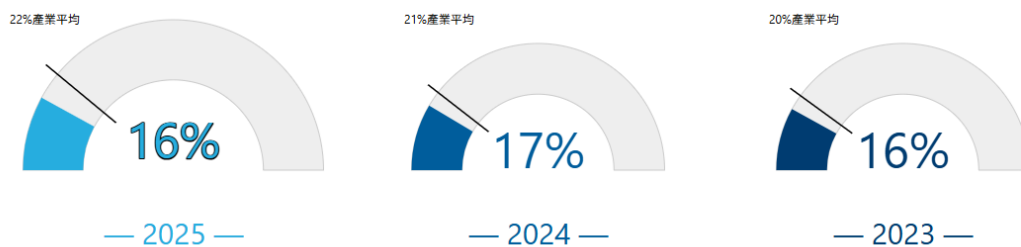
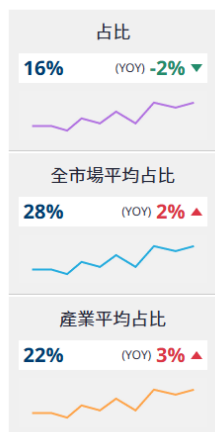
2025



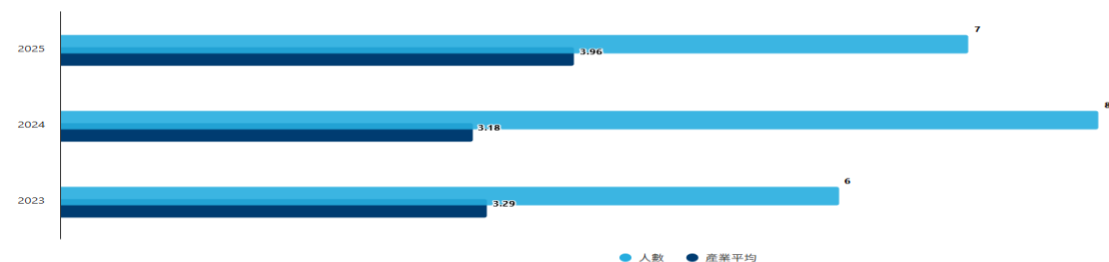
ESG 資訊-社會責任(Social)

管理職女性主管占比

2025



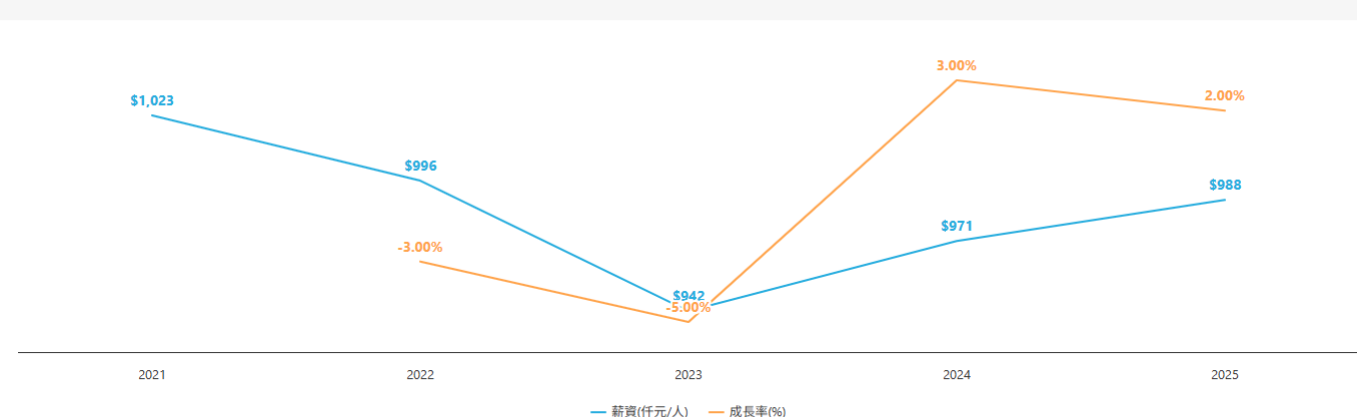
職業災害人數



2025



員工薪資年度趨勢

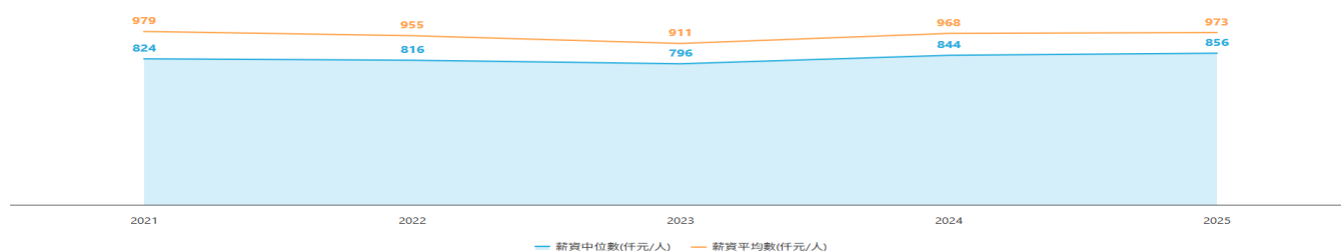


2025

員工薪資平均數	與去年同期比	與同產業薪資比
988	2% ▲	+5.07%

2026/07/23

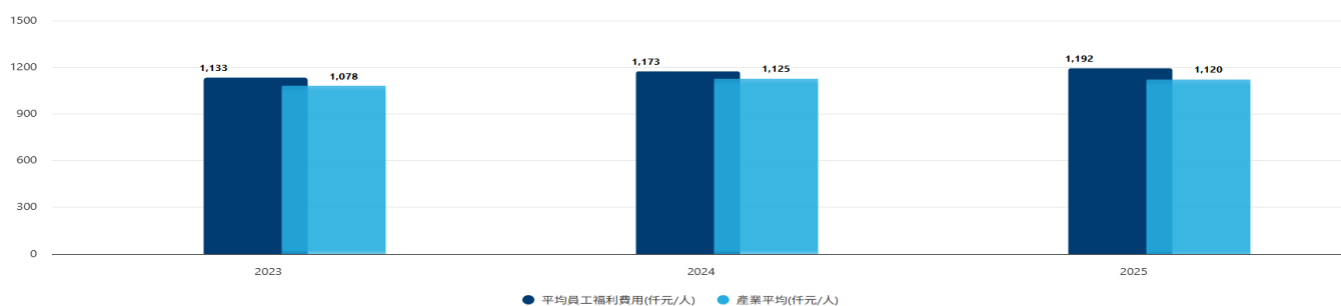
非擔任主管職務之全時員工薪資



2025



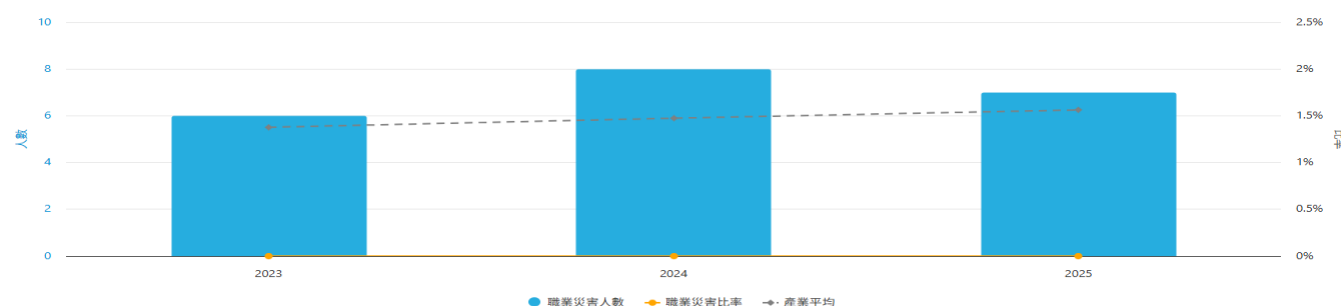
平均員工福利費用



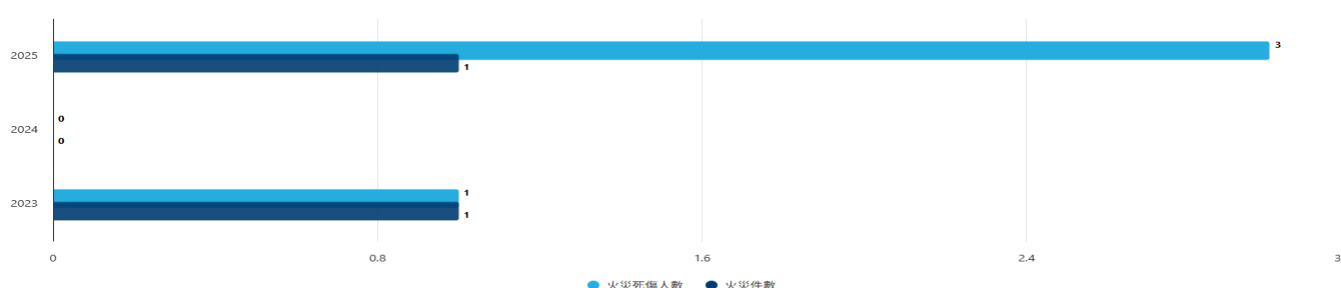
2025



職業災害人數與比率



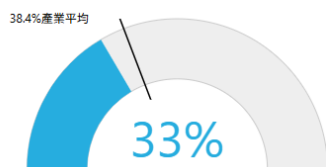
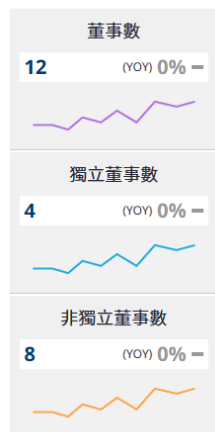
火災件數與死傷人數



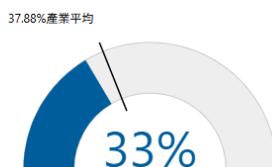
ESG 資訊-公司治理(Governance)

獨立董事vs.董事席次占比

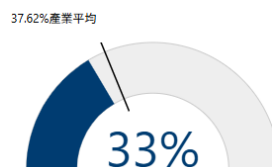
2025



— 2025 —

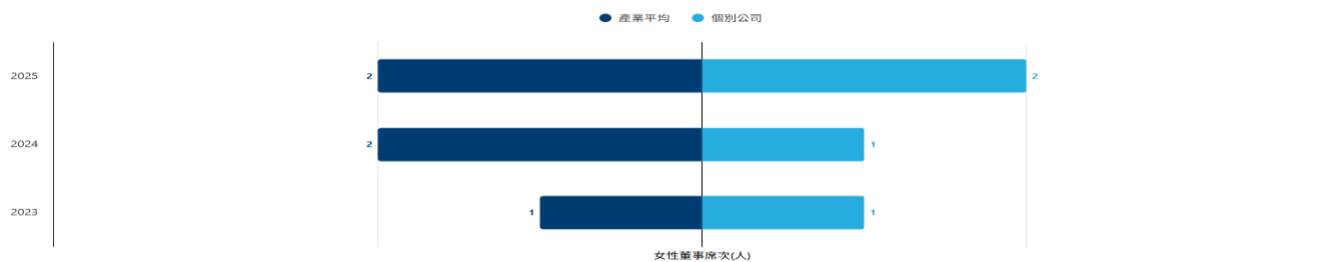


— 2024 —



— 2023 —

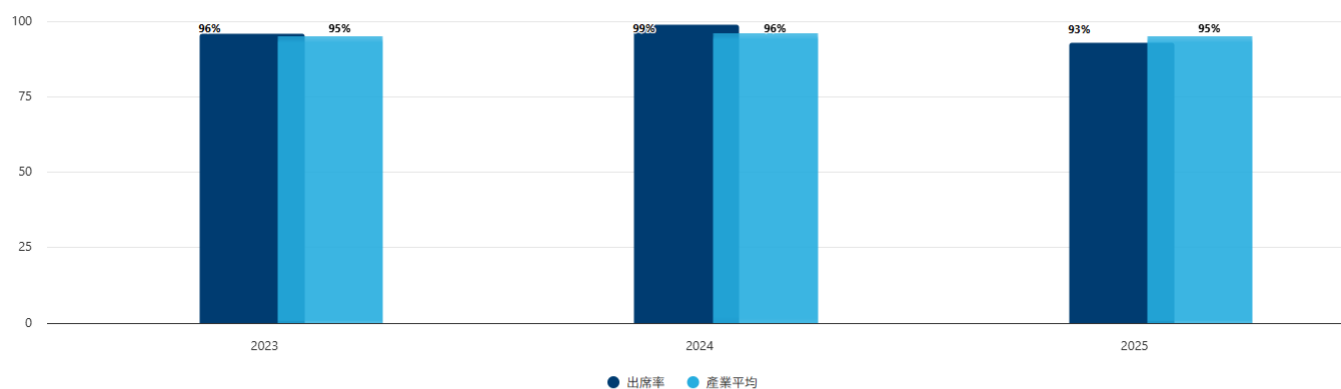
女性董事席次



2025



董事之董事會出席率



2025



2026/07/23

董事進修符合進修要點比率

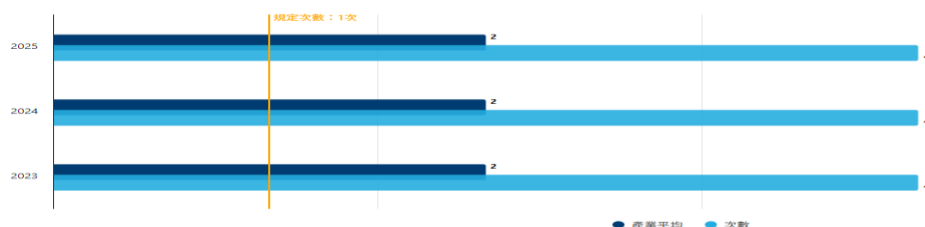


內圈:個別公司 外圈:產業平均

2025



法說會次數



2025



薪酬委員會出席率



內圈:個別公司出席率 外圈:產業平均

2025



薪酬委員會席次



資料來源：證交所

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號